

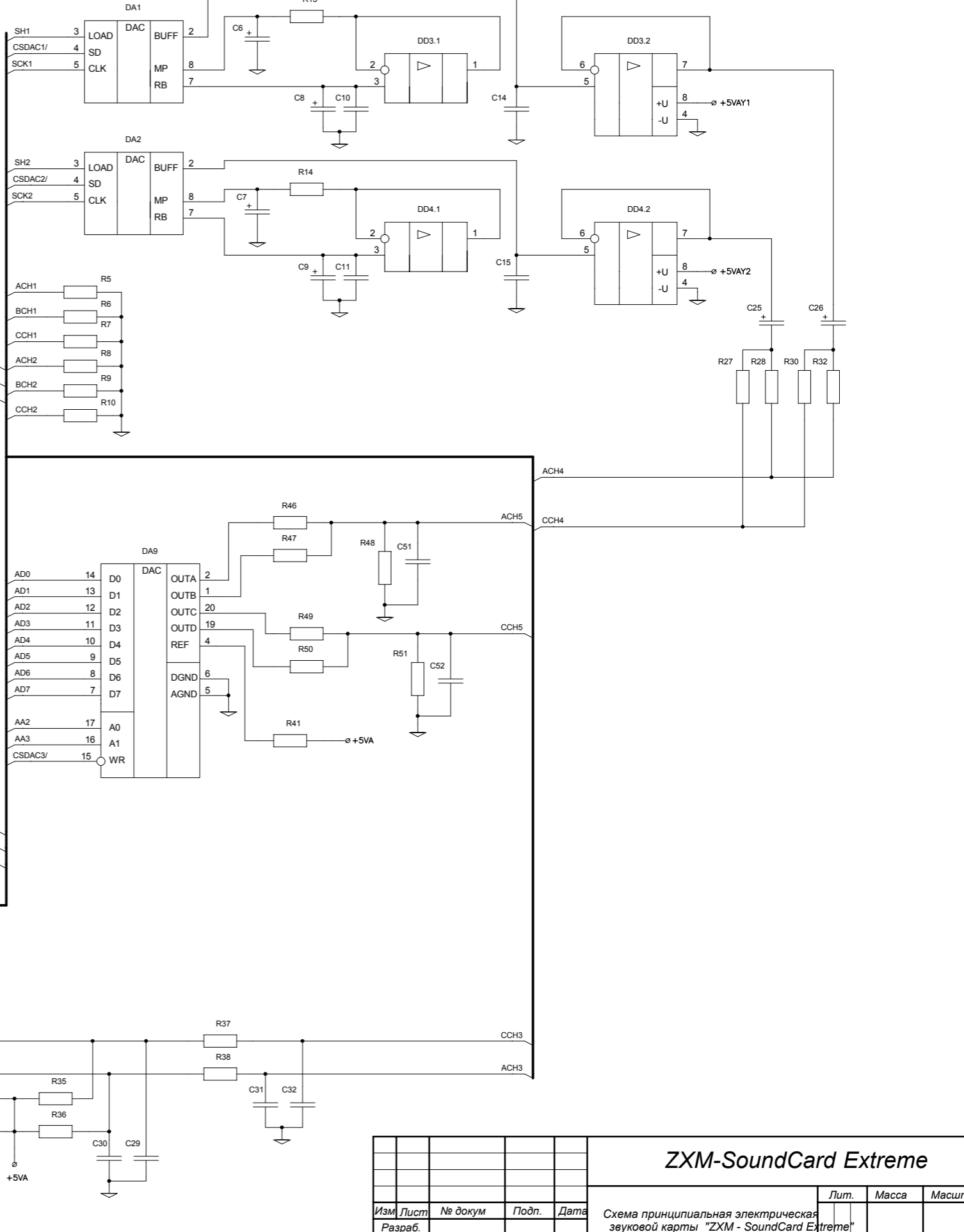
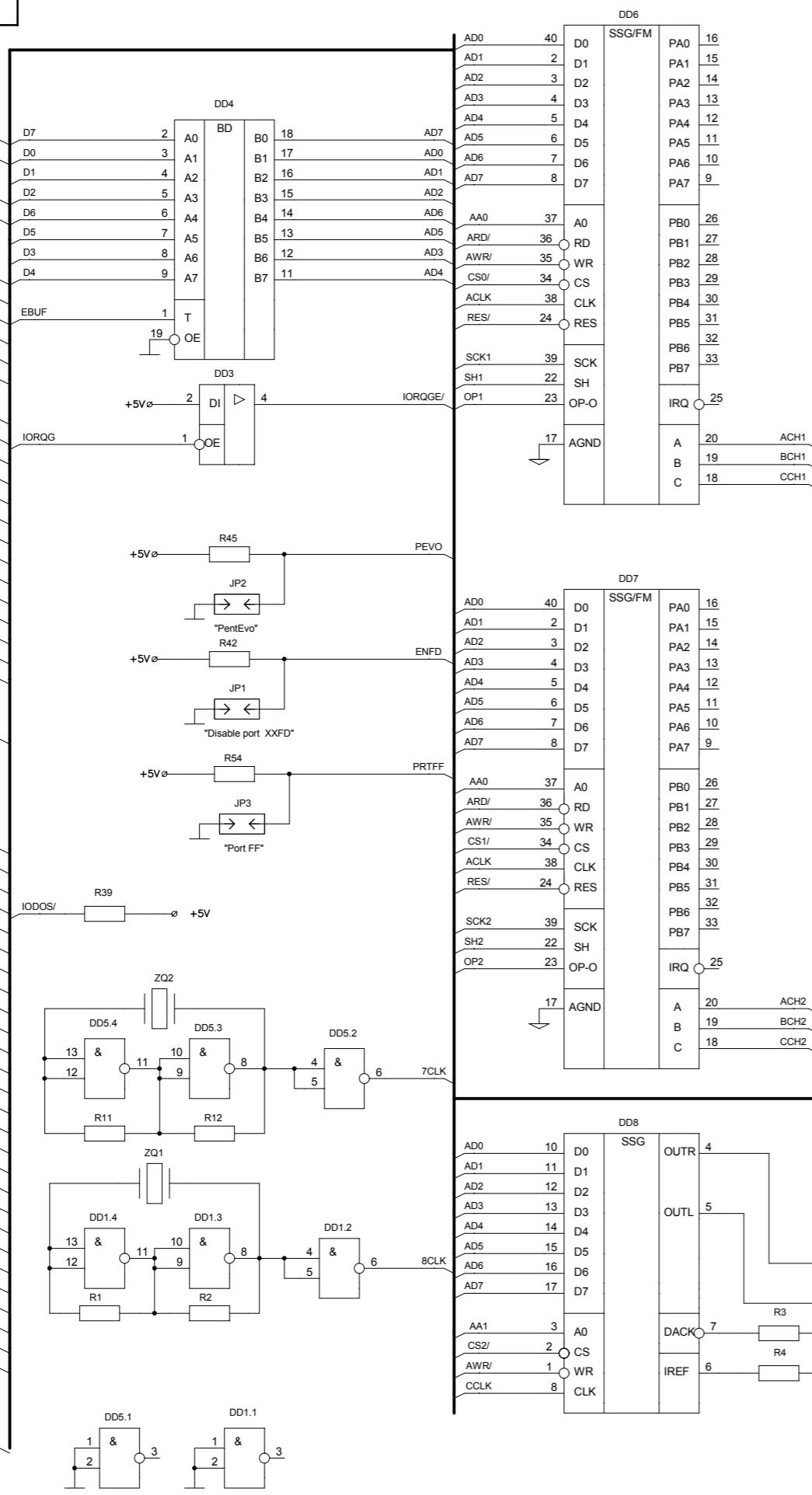
Перев. примен. Справа. № Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.

XP1.A "ZX BUS"

Контакт	Цепь
A14	1
A12	2
+5V	3
DOS/	4
F	5
GND	6
GND	7
CLK	8
A0	9
A1	10
A2	11
A3	12
IORQGE/	13
IORQGE	14
GND	15
RDR/	16
RS	17
	18
BRQ	19
RES	20
A7	21
A6	22
A5	23
A4	24
CSR/	25
BUSAK/	26
A9	27
A11	28
+5V	29
GND	30
-5V	31

XP1.B "ZX BUS"

Контакт	Цепь
A15	1
A13	2
D7	3
BLK	4
TURBO	5
D0	6
D1	7
D2	8
D6	9
D5	10
D3	11
D4	12
INT	13
NMI	14
HALT	15
MREQ/	16
IORQ	17
RD	18
WR	19
IODOS	20
WAIT	21
	22
	23
M1	24
RFSH	25
A8	26
A10	27
+5V	28
+12V	29
GND	30
-12V	31



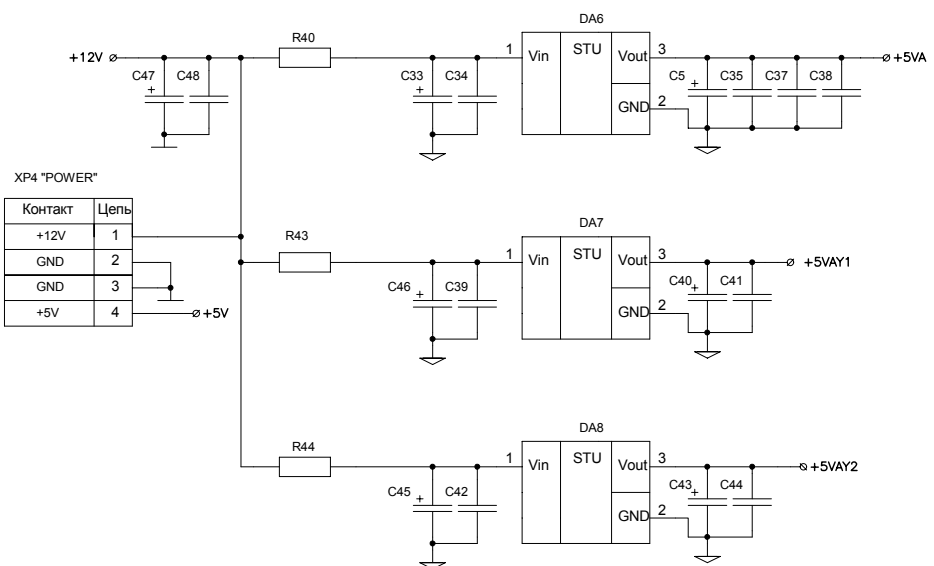
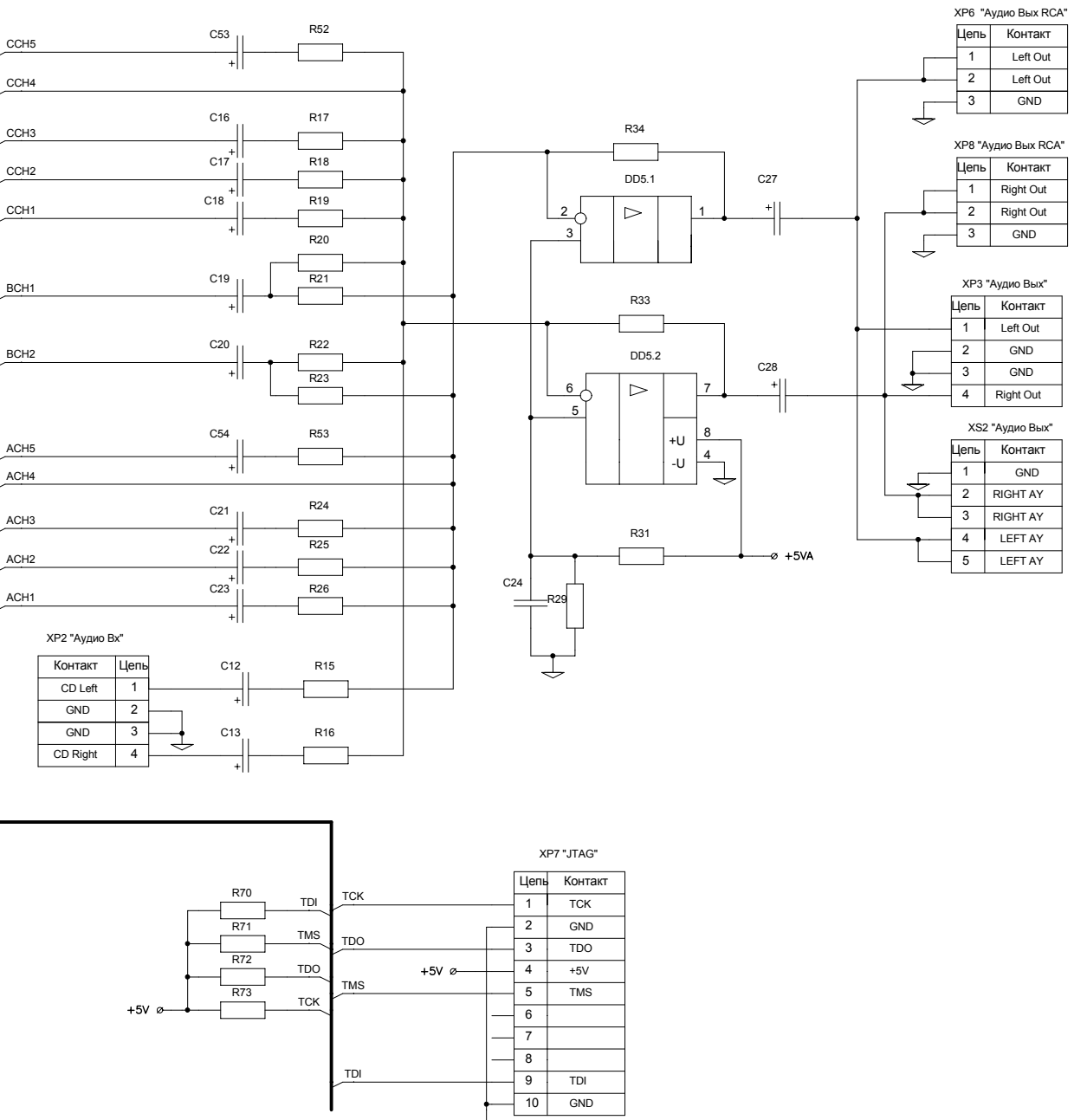
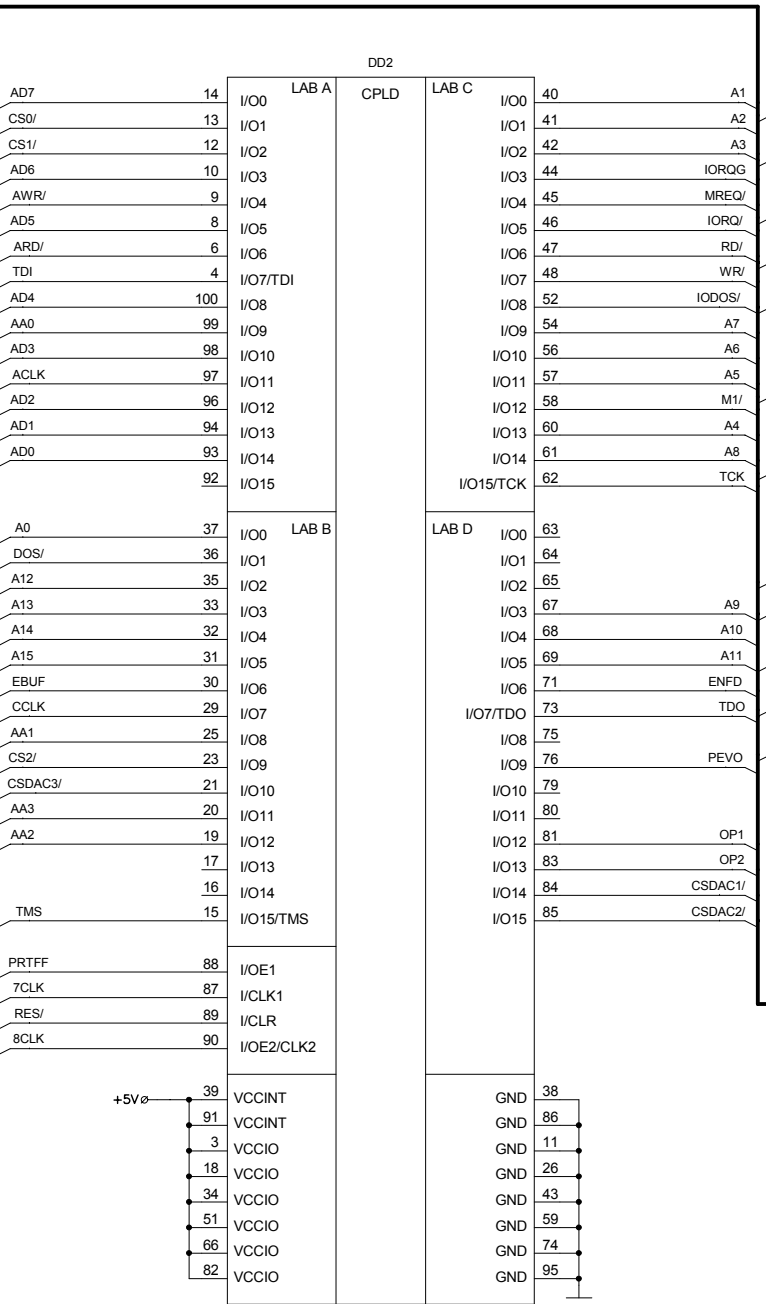
				ZXM-SoundCard Extreme			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Схема принципиальная электрическая звуковой карты "ZXM - SoundCard Extreme" вариант 2014 года.		
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					SAA+SounDrive+TSMF Edition revision 02		
Уте.					Лист Листов		micklab@mail.ru

XP5.A "ZX BUS"

Контакт	Цепь	Цепь	Контакт
A14	1	A14	AD7
A12	2	A12	CS0/
+5V	3	+5V	CS1/
DOS/	4	DOS/	AD6
F	5	EXT1	AWR/
GND	6		AD5
GND	7		ARD/
CLK	8	EXT2	TDI
A0	9	A0	AD4
A1	10	A1	AA0
A2	11	A2	AD3
A3	12	A3	ACLK
IORQGE	13	IORQGE/	AD2
GND	14		AD1
RDR/	15	EXT3	AD0
RS	16	EXT4	
	17	EXT5	
	18	EXT6	A0
BRQ	19	EXT7	DOS/
RES	20	RES/	A12
A7	21	A7	A13
A6	22	A6	A14
A5	23	A5	A15
A4	24	A4	EBUF
CSR/	25	EXT8	CCLK
BUSAK/	26	EXT9	AA1
A9	27	A9	CS2/
A11	28	A11	CSDAC3/
+5V	29	+5V	AA3
GND	30		AA2
-5V	31	EXT12	

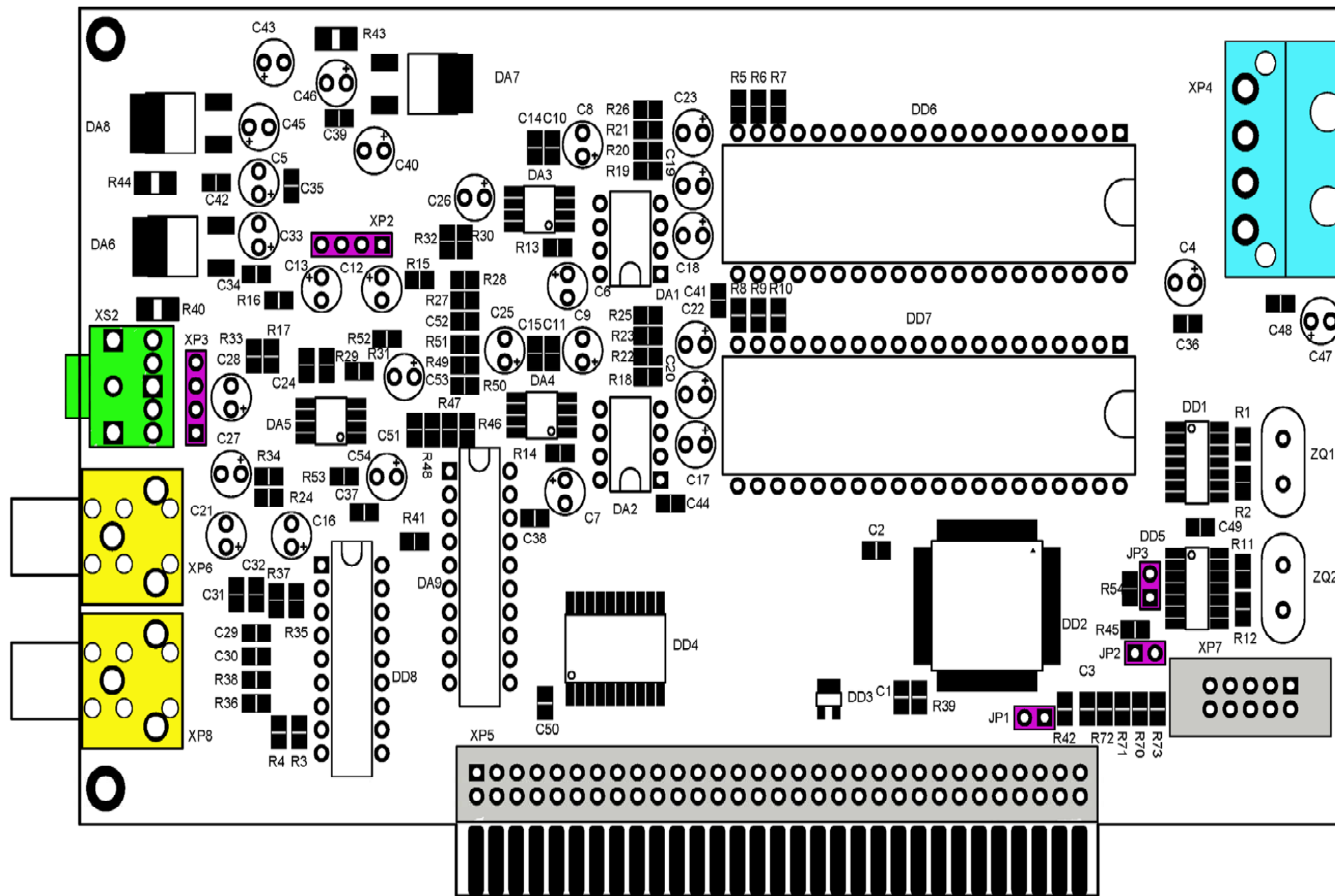
XP5.B "ZX BUS"

Контакт	Цепь	Цепь	Контакт
A15	1	A15	
A13	2	A13	
D7	3	D7	
BLK	4	EXT14	
TURBO	5	EXT15	
D0	6	D0	
D1	7	D1	
D2	8	D2	
D6	9	D6	
D5	10	D5	
D3	11	D3	
D4	12	D4	
INT	13	EXT16	
NMI	14	EXT17	
HALT	15	EXT18	
MREQ	16	MREQ/	
IORQ	17	IORQ/	
RD	18	RD/	
WR	19	WR/	
IODOS	20	IODOS/	
WAIT	21	EXT19	
	22	EXT20	
	23	EXT21	
M1	24	M1/	
RFSH	25	EXT22	
A8	26	A8	
A10	27	A10	
+5V	28	+5V	
+12V	29	+12V	
GND	30		
-12V	31	EXT24	



Примечание: Резисторы R55 и R56 разделяют две области металлизации печатной платы (цифровую и аналоговые части).

Име. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. №. Име. № дубл. Подл. и дата. Име. № подл.



Позиц. Обозначение.	Наименование	Позиц. Обозначение.	Наименование
<i>Микросхемы</i>		<i>Кварц. резонаторы</i>	
DD1, DD5	74HCT00D	ZQ1	HC-49S 8,0 мГц
DD2	EPM7064STC100-10 (TQFP-100)	ZQ2	HC-49S 7,0 мГц
DD3	74LVC1G125DBV		
DD4	74HCT245D		<i>Разъемы</i>
DD6, DD7	YM2203	XS1	ST-029N06
DD8	SAA1099	XP2, XP3	BLD-4
DA1, DA2	YM3014B	XP4	THP-4MR
DA3...DA5	LM358D	XP5	PLD-64
DA6...DA8	78M05CS	XP6, XP8	RS-162
DA9	TLC7226CN	XP7	BH-10
<i>Резисторы</i>		<i>Джамперы</i>	
R1, R2, R11, R12	RR0805 1,5 кОм	JP1...JP3	BLD-2
R3, R4, R17, R24, R33, R34, R46...R53, R70...R73	RR0805 10 кОм		
R5...R10	RR0805 3,3 кОм		
R13, R14	RR0805 470 Ом		
R15, R16, R18, R19, R25...R28, R30, R32	RR0805 24 кОм		
R20...R23, R31	RR0805 47 кОм		
R29	RR0805 27 кОм		
R35, R36, R41	RR0805 820 Ом		
R37...R39, R42, R45, R54	RR0805 1,0 кОм		
R40, R43, R44	RR1206 18 Ом		
R55, R56	RR0805 1 Ом		
<i>Конденсаторы</i>			
C1...C3, C10, C11, C24, C34...C39, C41, C42, C44, C48...C50	CC0805 0,1 мкФ		
C4, C47	K50 - 35 100мкФ x 15B		
C6...C9, C12, C13, C16...C23, C25...C28, C53, C54	K50 - 35 10мкФ x 15B		
C14, C15	CC0805 2200 пФ		
C29...C32	CC0805 0,01 мкФ		
C5, C33, C40, C43, C45, C46	K50 - 35 47мкФ x 15B		
C51, C52	CC0805 100 пФ		

Примечание:

- Сборку платы необходимо начинать с распайки дискретных SMD компонентов (резисторы и конденсаторы). Это важно потому, что потом их будет трудно запаять при установленных других компонентах.
- Резисторы R55 и R56 находятся с обратной стороны платы.